

電子機器2024 トータルソリューション展 6.12 Wed. → 14 Fri. 10:00-17:00 東京ビッグサイト 東展示棟



完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場! 事前登録のうえ、来場者バッジを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のバッジホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

www.jpccashow.com

事前来場登録のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願いいたします。本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

公式HPはこちら



事前登録/最新情報はHPをご覧ください

STEP.1 公式ホームページより来場登録へお進みください。STEP.2 ご登録いただいたメールアドレス宛に、パスワード設定のメールが届きます。24時間以内にパスワードの設定を完了してください。STEP.3 展示会当日、来場者マイページより来場者バッジをプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。

来場者参加型企画 ブースコンテスト 交流プラザ

開催概要 JPCA 2024 Show, JIEP, JISSO PROTEC 2024, METASOURCE DEVISE, WIRE Japan Show 2024, Electronics Component & Unit Show

会期: 2024年6月12日(水)~6月14日(金) 10:00~17:00 会場: 東京ビッグサイト 東展示棟

JPCA 賞表彰式 半導体オプ・ザ・イヤー2024 受賞製品・技術発表

JISSO PROTEC 特別講演 無料 要事前登録 セミナー会場G

電子機器トータルソリューション展 基調講演 有料 VIP/会員無料 要事前登録 セミナー会場A

PROTECセミナー 無料 要事前登録 セミナー会場H

JIEP最先端実装技術シンポジウム 有料 要事前登録 最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

Table with 2 main columns (A会場, B会場) and multiple rows of session titles and speakers.

JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場I

JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場B

製品安全セミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場B

ダントツものづくりセミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場C

JIEPアカデミックプラザ 無料 事前登録不要 セミナー会場E

Table with 2 main columns (6月12日(水), 6月13日(木), 6月14日(金)) and multiple rows of academic presentation titles.

製品化学物質管理セミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場B



※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は受付にご協力をお願いいたします。

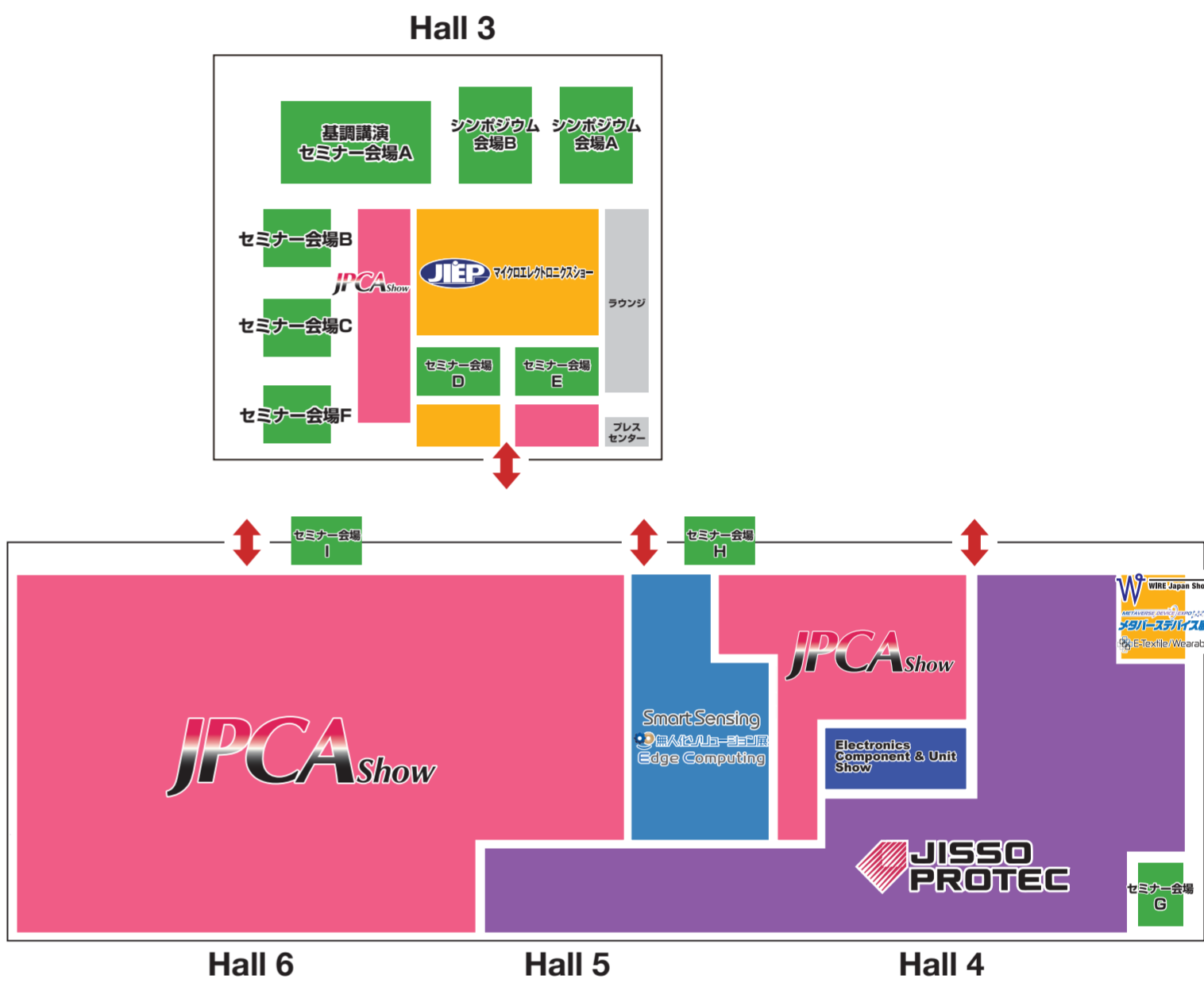
Table with 3 columns: Time, Title, and Organizer. Contains various technical presentations and seminars from 10:30 to 16:05.

Table with 3 columns: Time, Title, and Organizer. Contains keynote speeches and seminars from 10:15 to 13:45.

Table with 3 columns: Time, Title, and Organizer. Contains seminars from 13:45 to 14:45.

Table with 3 columns: Time, Title, and Organizer. Contains a panel discussion from 10:15 to 11:05.

Table with 3 columns: Time, Title, and Organizer. Contains a seminar from 15:00 to 15:30.



新企画 "アプリケーション・マップ" 自動運転, EV, パワー半導体/ガラス基板, アドバンスドパッケージ, 気候変動対策. Includes a search bar and category icons.

Large table listing exhibitors by industry: 3D-MID/PE, Wafer/Panel-Level Packaging, LE-TECHNOLOGY, AI活用, LTspice, Hanel PT, ICサブストレート製造, シャドープラス, 高密度貫通スルーホールコア基板, シンパのレーザーアブレーション加工機, 超・低消費動作を実現!, 基板分割はレーザーカットの時代へ, 基板製造・基板実装の異物不良ソリューション, 電子顕微鏡を使った電子部品の微細構造解析ソリューション, SCREENのPKG基板向け最新露光装置, デバイス実装材料の特性を見える化する!, SMTリフローに対するドイツ・IBL社の新たな取り組み, パワーデバイス向けリードフレーム用 粒状銅めっき添加剤, Vテクノロジーの製造業向けITソリューション, 大型の基板・実装部品に対応したディスペンサ技術, 電子回路基板用ドリル, ルーターの最新技術情報, 3D-MID/PEの社会実装と電子基板分野での脱炭素をIHリフロー自撮でトータルサポート, "経時変化の無い"マイルドプラズマ技術による表面改質効果, 熱設計のフロントローディングに役立つ熱シミュレーションツールの効果的な使い方, オンテックが自社開発したAI自動配置ツールのライブデモンストレーション!!, 新時代のプリント基板搬送: 軽量・汎用・ワンハンドで作業効率を劇的に向上!, パラジウム触媒付きアクリル箔が促す超微細かつ高周波対応のパッケージ基板へのイノベーション.

Smart Sensing 無人化ソリューション展 Edge Computing, WIRE Japan Show, Electronics Component & Unit Show, E-Textile/Wearable. Includes logos and lists of exhibitors.